

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

2024年2月28日—29日投资者关系活动记录表

编号：2024-01

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位 名称及人员姓名	国金基金 边广洁 财通证券 白宇 兴业证券 章林 长江资管 施展 方正资管 刘斐 国泰基金 李林珈 国泰基金 陈臻迪 国泰基金 王阳 中信证券 魏博 中信证券 赵兵兵 中信证券 孙真真 国元证券 郝润祺 国新证券 樊志斌 国新证券 李彬 西南证券 张大为 广发基金 张世杰 广发基金 杨定光 中航证券 郭鑫

	天风证券 谭振韬 海通证券 余伟民 海通证券 夏凡 鑫元基金 韩子龙 鸿道投资 田畅 浙商电子 王俊之 中邮基金 陈子龙 民生通信 马天诣 煜德投资 冯超 煜德投资 李贺 盘京投资 王莉 东北证券 史博文 中信建投 曹添雨 中欧基金 虞锦源 国新投资 张博 西部证券 尹一梦 诚旻投资 张萌 诚旻投资 王娅菲 大成基金 徐一清 长江养老保险 杨小林
时 间	2024 年 2 月 28 日—2024 年 2 月 29 日
地 点	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书、公司副总经理、证券事务代表及相关工作人员
投资者关系活 动主要内容介 绍	Q: 中瓷电子 IPO 募投项目建设情况, 2024 年是否可以释放产能? A: 公司 IPO 募投项目厂房已于 2023 年底建成投产, 产能和产

量正在逐步释放。公司将紧跟市场及技术方向，新产品开发和项目产品结构将随市场需求变化而调整。

Q：公司精密陶瓷零部件领域目前开发进度如何？可用于国产半导体关键设备的精密陶瓷零部件主要应用领域有哪些？

A：公司已开发了精密陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝核心材料和配套的金属化体系，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台，开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同类产品水平并通过用户验证，实现了关键零部件的研发生产，已批量应用于国产半导体关键设备中。2023 年精密陶瓷零部件的销售收入呈现增长的态势。

公司精密陶瓷零部件采用氧化铝、氮化铝等先进陶瓷经精密加工后制备的半导体设备用核心零部件，具有高强度、耐腐蚀、高精度等优异性能，应用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机、离子注入机等半导体关键设备中。

Q：公司重组完成后，公司如何看待重组后新增加的业务发展的趋势？

A：公司各项经营活动正常且顺利，我们认为目前大环境、市场、基本面没有重大不利影响，各分、子公司亦全力生产保障重组业绩预测承诺的实现。

博威公司氮化镓通信基站射频芯片与器件主要应用于 5G 通信大功率基站和 MIMO 基站。随着新一代 5G 移动通信对高频性能射频器件的需求持续旺盛，博威公司产品也在持续迭代。博威公司产品基本覆盖 5G 主要应用场景，同步开展微基站、小站等应用场景的氮化镓射频芯片与器件产品。根据每年终端客户建设不同用途、不同频段的基站，博威公司供应的产品也不同。

国联万众现有的碳化硅功率模块，主要应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，未来拟攻关高压碳化硅功率模块领域，进一步对高压碳化硅功率芯片（自用）和模块相关的刻蚀技术、氧化工艺、减薄技术、封装技术等方面进行深入研究，

抢占行业技术高地，在智能电网、动力机车、轨道交通等高压、超高压领域抢占市场份额，实现对 IGBT 功率模块的部分替代。

Q: 目前博威公司和国联万众，募投项目进展如何？

A: 博威公司的氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目、通信功放与微波集成电路研发中心建设项目以及国联万众公司的第三代半导体工艺及封测平台建设项目、碳化硅高压功率模块关键技术研发项目，均正在按计划进行中。

Q: 博威公司是否涉及星链通信产品？未来如何布局？

A: 博威公司紧密围绕当前合作用户需求，积极推进星链通信射频芯片与器件关键技术突破和研发工作，目前公司在星链通信相关芯片与器件领域储备关键技术和开发样品，并根据用户系统开发进程，稳步推进产品优化和产业化布局。

Q: 中瓷电子现在有布局 1.6T 光模块外壳吗？

A: 目前公司已有多款 1.6T 光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段，性能已通过客户验证，处于小批量交付阶段。同时，公司在积极开展现有业务的同时，也在不断探索和跟进行业发展趋势及市场需求。

Q: 国联万众的车规级碳化硅模块产能如何？后续的成长性如何？

A: 国联万众公司已开发系列的 1200VSiCMOSFET 产品，技术指标和性能媲美国外主流厂家产品，部分型号产品已批量供货中。电动汽车主驱用大功率 MOSFET 产品主要面向比亚迪，其他客户也在密切接触、合作协商、送样验证等阶段中。

国联万众公司车规级碳化硅 MOSFET 模块已向国内一线车企稳定供货超过数百万只。电动汽车主驱用大功率 MOSFET 产品也已经通过参数验证，正在进行上车前批产验证。

Q: 公司今年计划进行股权激励方案吗？

A: 公司会持续构建高效能、高凝聚力的人才架构体系。未来公司将持续完善员工激励制度，建立共创、共享、共担的长效激

	<p>励机制，让员工一起分享企业成长带来的价值。未来如公司实施股权激励计划，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>Q: 公司对于未来几年市值管理有无计划?</p> <p>A: 公司重视市值管理，致力于持续提升经营管理，推动高质量发展，向市场传递价值。</p> <p>公司每年制定投资者沟通工作方案，通过制定信息披露平台以及股东大会、路演、反向路演（公司开放日）、接待来访、公司网站专栏等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，加强重要投资者日常维护。</p> <p>公司综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红等多种方式优化股东回报。公司积极推动公司市场价值与内在价值相匹配，维护股东权益，不断推动公司市场价值与内在价值相匹配。</p> <p>Q: 公司主营的电子陶瓷业务，对标日本京瓷有什么优势?</p> <p>A: 公司掌握了电子陶瓷外壳核心材料和技术的知识产权，具备质量、管理、品牌等多方面竞争优势，开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域，实现了关键核心部件的替代。公司布局精密陶瓷零部件领域，面向半导体设备零部件的需求，持续开发陶瓷材料体系，利用成熟的制造工艺平台，实现加热盘和静电卡盘等技术难度高的精密零部件研发生产，解决国产半导体设备行业的突出问题，拓展公司产品领域。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年3月4日